

# 哪里可以做切片分析？切片分析的原理及用途

产品名称	哪里可以做切片分析？切片分析的原理及用途
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司检测认证
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层（注册地址）
联系电话	0755-23312011 17603089103

## 产品详情

切片分析原理：

翹液恣提麟夥纒照种裏匪變查歷丞逮犍研磨繼撻饒教補制機齒潔统检嫻隸腦墨露敬燕手國封切研磨用抛

切片分析目的：

电子元器件表面及内部缺陷检查及SMT制程改善&验证。

切片分析检测标准

切片分析常规标准：IPC-TM-650 2.1.1 E05/04

切片分析检测项目

1.PCB结构缺陷：PCB分层，孔铜断裂等

2.PCBA焊接质量检测：

a. BGA空焊，虚焊，孔洞，桥接，上锡面积等；

b. 产品结构剖析：电容与PCB铜箔层数解析，LED结构剖析，电镀工艺分析，材料内部结构缺陷等；

c. 微小尺寸量测（一般大于1um）：气孔大小，上锡高度，铜箔厚度等。

使用仪器：精密切割机，镶埋机，研磨及抛光机，金相显微镜，电子显微镜等。

测试流程：取样 镶埋 研磨 抛光 观察拍照

切片分析主要用途：

是一种观察样品截面组织结构情况的常用的制样手段，

- 1、切片后的样品常用立体显微镜或者金相测量显微镜观察；
- 2、切片后的样品可以用于SEM/EDS扫描电镜与能谱观察形貌与分析成份；
- 3、作完无损检测如x-ray，SAM的样品所发现的疑似异常开裂、异物嵌入等情况，可以用切片的方法来观察验证；
- 4、切片后的样品可以与FIB联用，做更细微的显微切口观察。